

缘， 交流 压

国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力

以下模块皆为强迫风冷， 以上模块，风冷，水冷先用

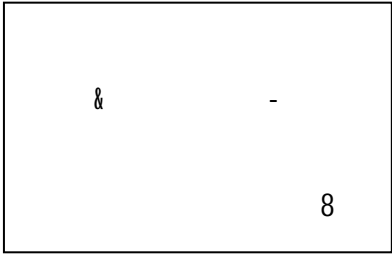
型应用

交直流 机控制，各种整流 源

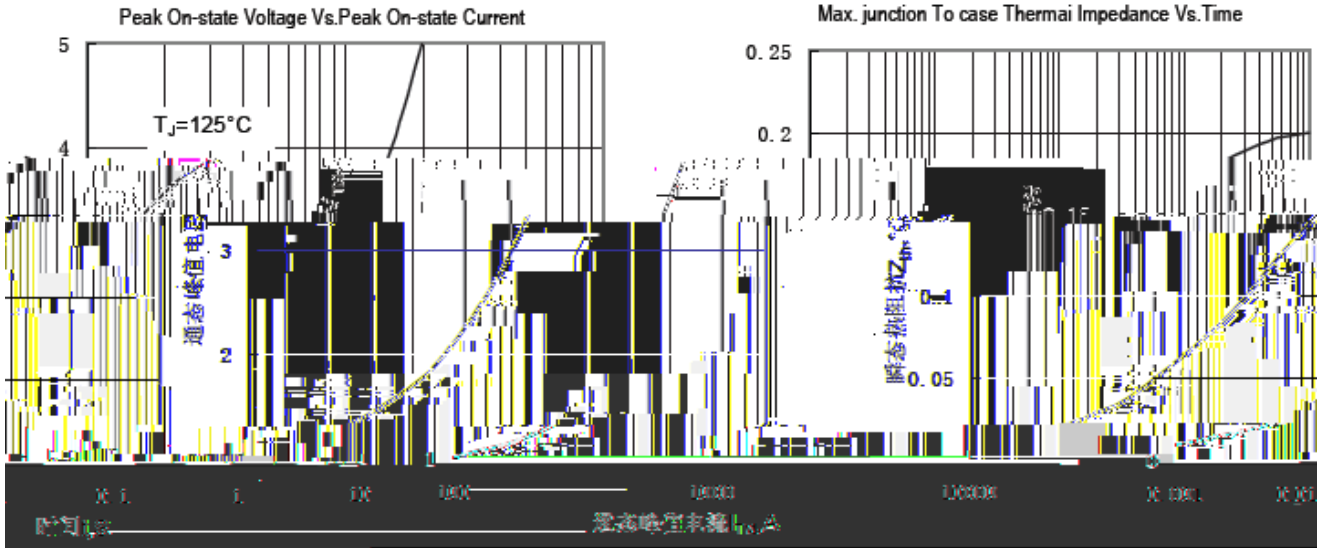
工业加热控制，调光，无触发点开关

机软起动，静止无功补偿

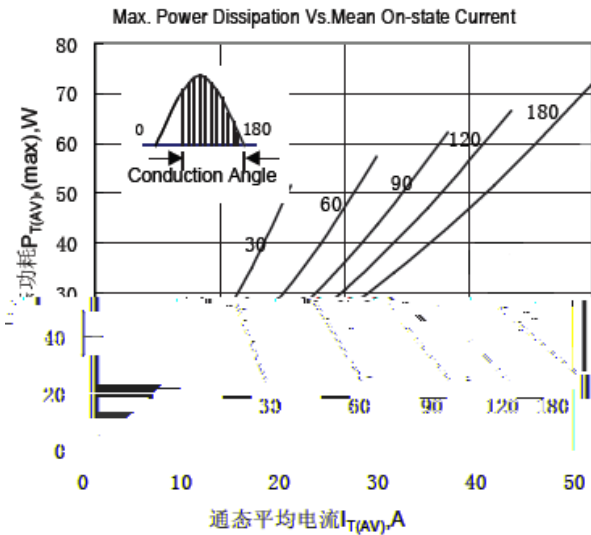
焊机，变频器， 源， 池充放



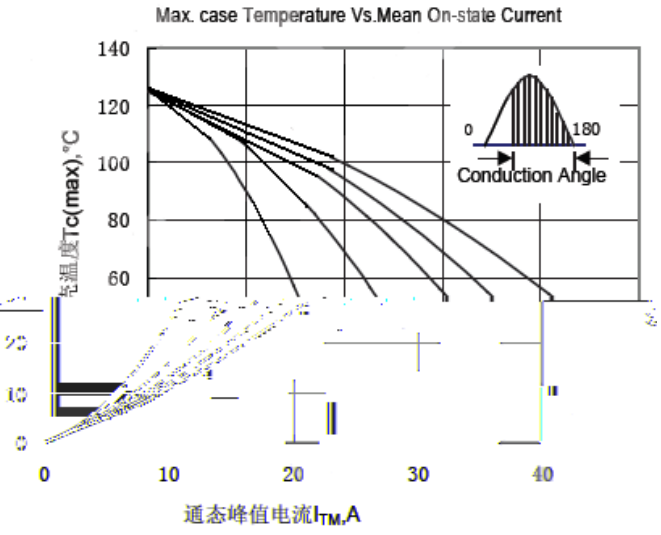
				最小	典型	最大	
!							
"							
		#					
\$\$							'
(\$)	'				'
)							
)		*					
)							
+ , -							/
+ . - +							/
(0							
1							2-
							2-
3	储			-#			
/							4
! ' 5(67							



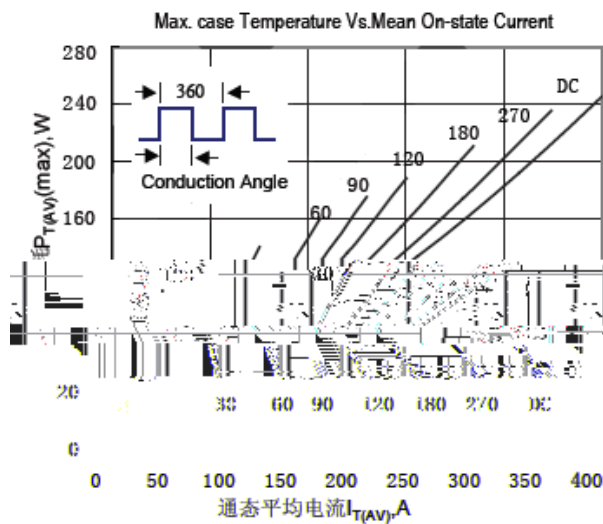
结至管壳瞬 热阻抗



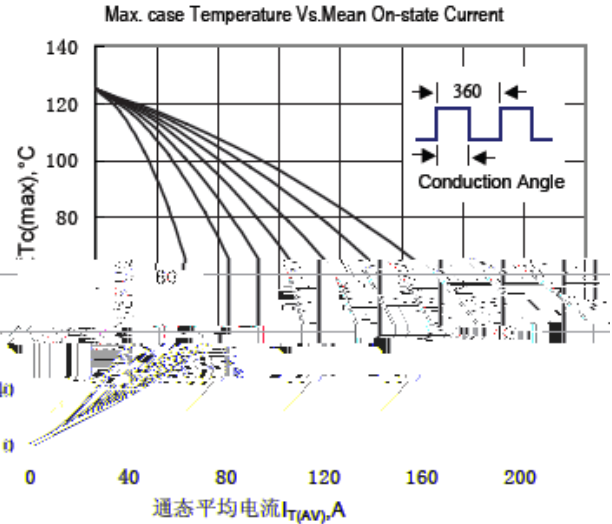
最大功耗与平均电流关系



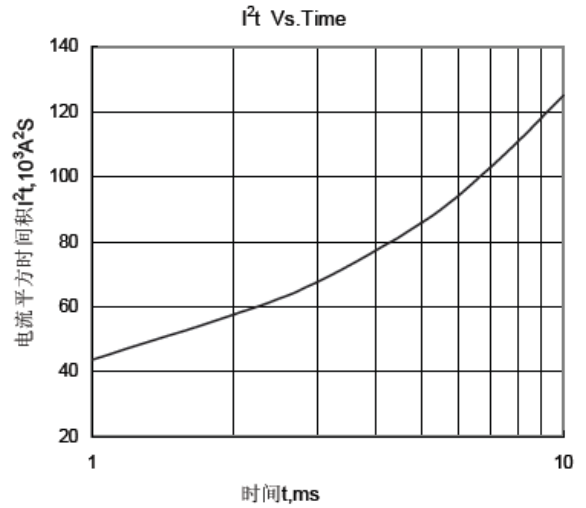
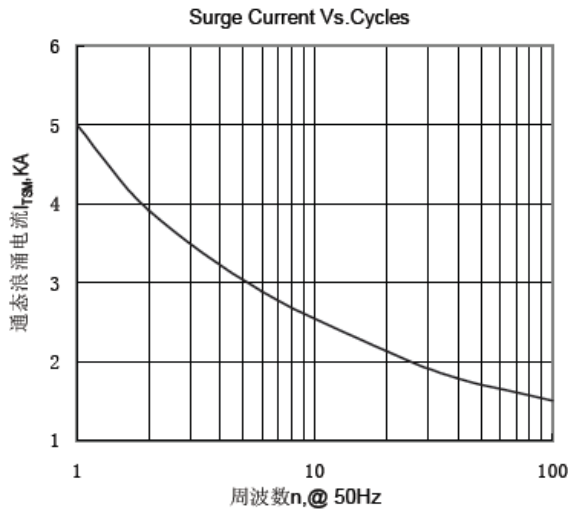
管壳温度与 平均电流关系



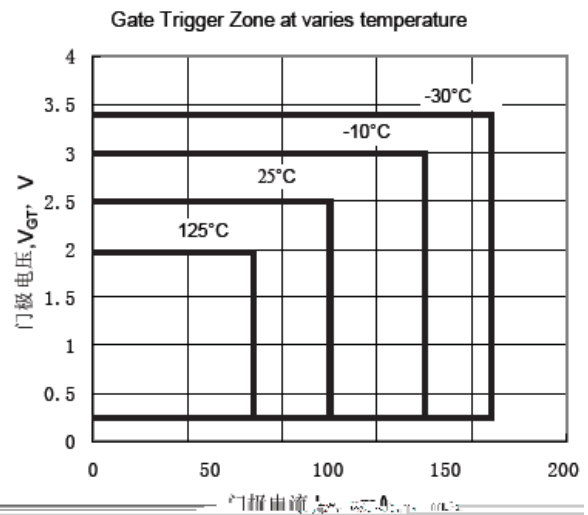
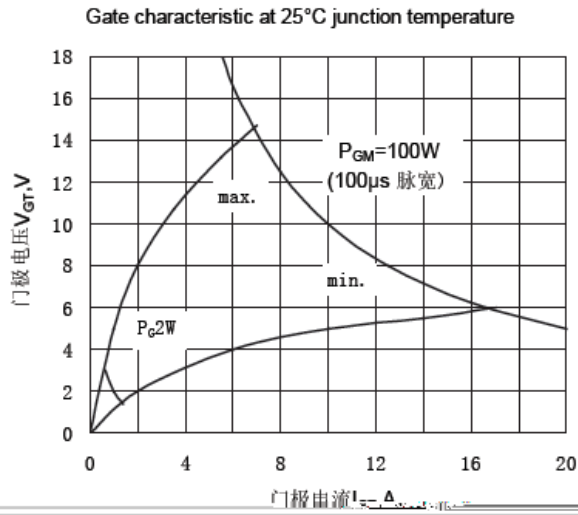
最大功耗与平均电流关系



管壳温度与 平均电流关系



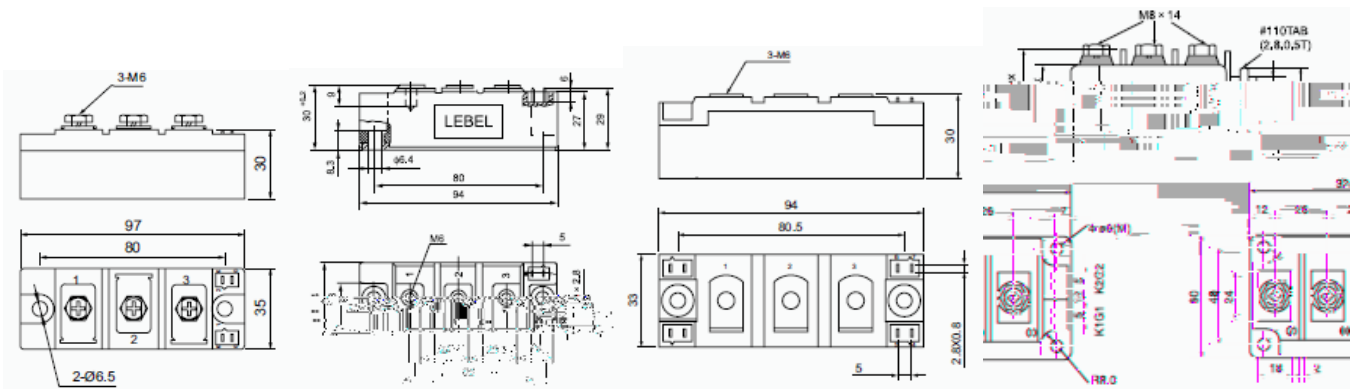
浪涌电流与周波数的关系



门极功率

门极触发

外形图:



图

图

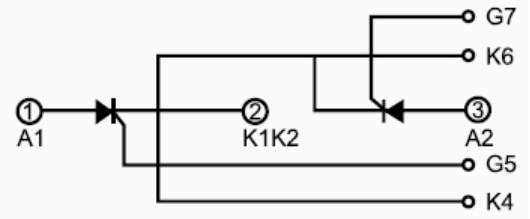
图

图

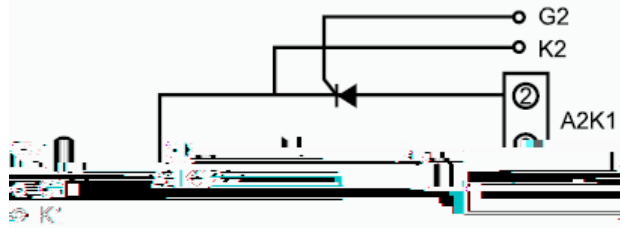
线路图：



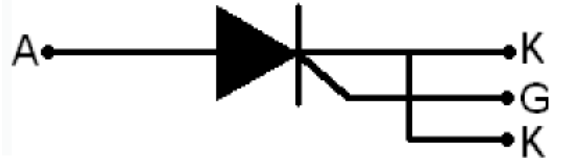
MTK



MTX



MT



MTA

